

**DIN 32564-2****DIN**

ICS 01.040.39; 39.020

**Fertigungsmittel für Mikrosysteme –  
Begriffe –  
Teil 2: Basistechnologien und Herstellung**

Production equipment for micro-systems –  
Terms and definitions –  
Part 2: Basic technologies and production

Équipement de production pour systèmes microtechniques –  
Termes et définitions –  
Partie 2: Technologies fondamentales et production

Gesamtumfang 5 Seiten

Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) im DIN

## Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss „Fertigungsmittel für Mikrosysteme“ im Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

DIN 32564 „Fertigungsmittel für Mikrosysteme — Begriffe“ besteht aus:

- Teil 1: Allgemeine Begriffe der Mikrosystemtechnik
- Teil 2: Basistechnologien und Herstellung
- Teil 3: Handhabung, Lagerung und Transport

## Einleitung

Diese Norm soll die Begriffe in dem relativ neuen Gebiet Mikrosystemtechnik zu einem Zeitpunkt klären, wo erste Produkte auf den Markt kommen. Es ist beabsichtigt, die Norm regelmäßig zu aktualisieren, um sie den Bedürfnissen von Kunden und Herstellern von Fertigungsmitteln anzupassen. Später sollen Definitionen aus anderen Normen, die mit Mikrosystemtechnik zu tun haben, hinzugefügt werden.

## 1 Anwendungsbereich

Diese Norm definiert Begriffe, die für Basistechnologien zur Herstellung von Mikrosystemen eingesetzt werden. Sie hat den Zweck, durch Festlegung einer einheitlichen Begriffsbildung die Verständigung über technische Inhalte zu erleichtern.

## 2 Begriffe

### 2.1 Basistechnologien

#### 2.1.1

##### **Bonden**

Fügetechnik zur mechanischen und/oder elektrischen Verbindung von Substraten oder Wafern und von Mikrokomponenten oder Chips mit Montageflächen

#### 2.1.1.1

##### **Die-Bonden**

ganzflächiges Verbinden von vereinzelt Halbleiterbauelementen mit Montageflächen

ANMERKUNG Das Basismaterial der vereinzelt Halbleiterbauelemente kann z. B. aus Metallen, Polymeren, Keramiken, Gläsern, Halbleitern bestehen.

#### 2.1.1.2

##### **Draht-Bonden**

Fügetechnik zur Herstellung diskreter elektrischer Drahtverbindungen vom Chip auf die Montagefläche

ANMERKUNG 1 Neben lateralen Drahtverbindungen kann auch eine Höhendifferenz überwunden werden.

ANMERKUNG 2 Spezielle Verfahrensformen sind z. B. Thermokompressions-Bonden, Ultraschall-Bonden, Ball-Wedge-Bonden, Wedge-Wedge-Bonden.